per	Telefax	vorab
via T	elefax in a	dvance
5	Seiten	/ pages

Der Antrag ist bei der zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder, wenn zwei oder mehr Behörden zuständig sind, bei der vom Anmelder gewählten Behörde einzureichen. Der Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Code der Behörde auf der nachstehenden Zeile angeben.

TPEA/ EP

### **PCT**

KAPITEL II

# ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

nach Artikel 31 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens:

Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daß für die nachstehend bezeichnete internationale Anmeldung die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt wird.

Von der mit der i	internationalen vorläufigen Pr	üfung beauftragter	Behörde auszufüllen	
von der mit der internationalen vorlaung				
Bezeichnung der IPEA	Eing	gangsdatum des A	NIRAGS	
Feld Nr. I KENNZEICHNUNG DEI	R INTERNATIONALEN A	NMELDUNG	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts T 45106WO/NZ/sb	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007970	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 16. Juli 2004		(Frühester) Prioritätstag (Tag/Monat/Jahr) 23. Juli 2003 (23.07.2003)	
Bezeichnung der Erfindung Sicherheitselement zur RF-Identifikat	(16.07.200 tion	4)	(10.07.11.00)	
Feld Nr. II ANMELDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorna Bezeichnung. Bei der	llständige amtliche ler Name des Staats	Telefonnr.:		
OVD Kinegram AG		Telefaxnr.:		
Zählerweg 12 CH-6301 Zug		Fernschreibnr.:		
Schweiz			Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:	
Staatsangehörigkeit (Staat):		tz oder Wohnsitz ( CH	Staat):	
•	bei juristischen Personen vollständige amtl	iche Bezeichnung. Bei der	Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
Norbert LUTZ Am Waldfriedhof 7 DE-90607 Rückersdorf Deutschland				
Staatsangehörigkeit (Staat):  DE  Sitz oder Wohnsi  DE			(Staat):	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; John Anthony PETERS Erlenweg 3B CH-8804 Au Schweiz	bei juristischen Personen vollständige amtl	liche Bezeichnung. Bei der	Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
Staatsangehörigkeit (Staat):		itz oder Wohnsitz CH	(Staat):	
Weitere Anmelder sind auf einem	Fortsetzungsblatt angegeben.			

Blatt Nr. . . 2 . . .

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007970

Feld Nr. III ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT					
Die folgende Person ist X Anwalt gemeinsamer Vertreter					
und ist vom (von den) Anmelder(n) bereits früher bestellt worden und vertritt ihn (sie) auch für die internationale vorläufige Prüfung.					
wird hiermit bestellt; eine etwaige frühere Bestellung eines Anwalts/geme	einsamen Vertreters wird hiermit widerrufen.				
wird hiermit zusätzlich zu dem bereits früher bestellten Anwalt/gemeinsa mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde bestellt.	amen Vertreter, nur für das Verfahren vor der				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	Telefonnr.: +49 911 - 510360				
Norbert ZINSINGER et al.	Telefaxnr.:				
Louis • Pöhlau • Lohrentz	+49 911 - 511342				
Postfach 30 55	Fernschreibnr.:				
DE-90014 Nürnberg	Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt:				
Deutschland	registrerungsin, des Anwais beim Aint.				
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt od dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben wird.	er gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt				
Feld Nr. IV GRUNDLAGE DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜF	UNG				
Erklärung betreffend Änderungen:*					
1. Der Anmelder wünscht, daß die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage					
der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung					
der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung					
unter Berücksichtigung der Änderungen nach Artikel 34					
der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung					
unter Berücksichtigung der Änderungen nach Artikel 19					
(ggf. zusammen mit einer Erklärung) unter Berücksichtigung der Änderungen nach Artikel 34					
der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung unter Berücksichtigung der Änderungen nach Artikel 34					
aufgenommen wird.					
2. Der Anmelder wünscht, daß jegliche nach Artikel 19 eingereichte Änderung de	r Ansprüche als überholt angesehen wird.				
3. Der Anmelder wünscht, daß der Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung maßgeblichen Frist aufgeschoben wird.	bis zum Ablauf der nach Regel 69.1 Absatz d				
4. Der Anmelder wünscht ausdrücklich, daß die internationale vorläufige Prüfung bereits vor Ablauf der nach Regel 54bis.1 Absatz a maßgeblichen Frist beginnt.					
* Wenn kein Kästchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorläufigen Prüfung auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung begonnen; wenn eine Kopie der Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 und/oder Änderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 34 bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schriftlichen Bescheids oder des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts begonnen hat, wird jedoch die geänderte Fassung verwendet.					
Sprache für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung: deutsch ;					
dies ist die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wurde.					
dies ist die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht wurde.					
dies ist die Sprache der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung.					
dies ist die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht wurde/wird.					
Feld Nr. V BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWÄHLTE STAATEN					
Die Einreichung dieses Antrags umfaßt die Auswahl aller Vertragsstaaten, die bestimmt wurden und durch Kapitel II des PCT gebunden sind.					

Blatt Nr. . . 3 . . .

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007970

Feld Nr. VI KONTROLLISTE			1, 5,,,,,	3 1,001 01 0		
Dem Antrag liegen folgende Unterlagen für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung in der in Feld Nr. IV angegebenen Sprache bei:			Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde auszufüllen			
			erhalten	nicht erhalten		
1. Übersetzung der internationalen Anmeldung		Blätter				
2. Änderungen nach Artikel 34 :		G Blätter				
Kopie (oder, falls erforderlich, Übersetzung)     der Änderungen nach Artikel 19 :		Blätter				
Kopie (oder, falls erforderlich, Übersetzung)     einer Erklärung nach Artikel 19 :		Blätter				
5. Begleitschreiben :		5 Blätter				
6. Sonstige (einzeln aufführen) :		Blätter				
Dem Antrag liegen außerdem die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:  1.  Blatt für die Gebührenberechnung						
Norbeyt Zildsinger, Patentanwalt (Zusammenschluss Nr. 39)  Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde auzufüllen						
1. Datum des tatsächlichen Eingangs des ANTRAGS:	_					
Geändertes Eingangsdatum des Antrags aufgrund von     BERICHTIGUNGEN nach Regel 60.1 Absatz b:						
<ul> <li>Das Eingangsdatum des Antrags liegt NACH Abl von 19 Monaten ab Prioritätsdatum; Punkte 4 und unten, finden keine Anwendung.         <ul> <li>Der Anmelder wurde entsprechend unterricht</li> </ul> </li> <li>Das Eingangsdatum des Antrags liegt weg Fristverlängerung nach Regel 80.5 INNERHALB v 19 Monaten ab Prioritätsdatum.</li> </ul>	et. 7.	nach Regel 54. 7 und 8, unten Das Eingan Fristverlänger	bis.1 Absatza vorgesc a, finden keine Anwen agsdatum des An	trags liegt wegen NNERHALB der nach		
5. Das Eingangsdatum des Antrags liegt nach Ablauf v 19 Monaten ab Prioritätsdatum, der verspätete Einga ist aber nach Regel 82 ENTSCHULDIGT.	on 8.	Regel 54bis.1 A		et nach Ablauf der nach nen Frist, der verspätete TSCHULDIGT.		
Vom Internationalen Büro auszufüllen						
Antrag vom IPEA erhalten am:						

# LOUIS · PÖHLAU · LOHRENTZ

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

DIPL.-PHYS. CLAUS PÖHLAU<sup>Δ</sup> DR.-ING. WALTER KÖHLER<sup>Δ</sup> DR. ARMIN WALCHER (CHEM.)<sup>Δ</sup> DIPL.-ING. NORBERT ZINSINGER<sup>Δ</sup>

DIPL.-PHYS. WOLFG. SEGETH<sup>Δ</sup> DANIELA ANTLSPERGER<sup>©</sup> DIPL-ING. F LOHRENTZ (1971-1999)

Europäisches Patentamt Erhardtstraße 27

80331 München

IAP15 Bec'd PCT/PTO 13 JAN 2006

90014 NÜRNBERG/GERMANY POSTFACH/P.O. BOX 30 55

TELEFON: +49-911-51 03 60 TELEFAX: +49-911-51 13 42 E-MAIL: office@burgpatent.de

HAUSANSCHRIFT/PREMISES: 90409 NÜRNBERG/GERMANY MERIANSTRASSE 26

T/45106WO/NZ/RT Unser Zeichen / Our reference

10. Mai 2005

Internat. Patentanmeldung

Anmeldung Nr.

: PCT/EP2004/007970 : WO2 2005/010809

Veröffentlichungsnr. Offizieller Titel

: Sicherheitselement zur RF-Identifikation

Anmelder / Inhaber

: OVD Kinegram AG

Auf den int. Recherchenbericht und den schriftlichen Bescheid der int. Recherchenbehörde:

Es werden neue Patentansprüche 1 bis 18 eingereicht, welche die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 22 ersetzen sollen. Es wird eine Reinfassung der neuen Patentansprüche wie auch eine Fassung eingereicht, in welcher die vorgenommenen Änderungen im Detail aufgezeigt sind (ergänzte Passagen fett gedruckt, herausgenommene Passagen durchgestrichen).

Der neue Anspruch 1 basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 2, 6, 12 und 13 sowie der Beschreibung der Patentanmeldung Seite 4, letzter Absatz. Weiterhin wurde in Anspruch 1 das Merkmal eingefügt, dass die Rillen der Reliefstruktur sowohl in der, der Substratschicht zugewandten Oberfläche als auch der, der Substratschicht abgewandten Oberfläche der ersten elektrisch leitenden Schicht ausgebildet sind. Dies ergibt sich eindeutig aus der Figurendarstellung 2a der Patentanmeldung.

Die neuen Ansprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3 bis 5.

Die neuen Ansprüche 5 bis 9 entsprechen im wesentlichen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 7 bis 11.

Die neuen Ansprüche 10 bis 15 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 14 bis 19.

Der neue Anspruch 16 basiert auf dem ursprünglich eingereichten Anspruch 20 und wurde analog zum neuen Anspruch 1 geändert.

Die neuen Ansprüche 17 und 18 entsprechen im wesentlichen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 21 und 22.

Im Hinblick auf die Entgegenhaltungen **D1: WO-A-97/21184** und **D2: DE-A-10 118 487** wird folgendes erwidert:

D1 offenbart in Anspruch 1 eine Sicherheitseinrichtung mit einem Substrat, dessen eine Oberfläche ein Oberflächenreliefmuster beinhaltet. Ein Metallmuster, welches eine Antenne oder ein Element einer Kapazität (siehe Seite 7, Zeilen 28 bis 32) bildet, ist darauf im Register mit dem Oberflächenreliefmuster angeordnet. Auch die Ansprüche 4 und 8 der D1 offenbaren einen solchen Sachverhalt. In den Figuren 6A und 6B der D1 ist ein Substrat 605 gezeigt, auf welchem ein Hologramm angeordnet ist. Das Oberflächenreliefmuster 601 des Hologramms ist mit einer gitterförmig ausgestalteten, semitransparenten Metallschicht 603 bedeckt, wobei lediglich die Oberfläche der Metallschicht, die dem Oberflächenreliefmuster 601 zugewandt ist, dem Verlauf des Oberflächenreliefmusters 601 folgt.

Wo aufgrund der gitterförmigen Ausgestaltung der Metallschicht 603 keine Metallschicht vorhanden ist, kann folglich auch keine Reliefstruktur darin abgeformt sein. Ein Gleichsetzen des Gitterprofils der Metallschicht mit der ersten Reliefstruktur des neuen Anspruchs 1 ist somit nicht möglich!

Im Hinblick auf die neuen Ansprüche 1 und 16 der Patentanmeldung ist festzustellen, dass D1 nicht offenbart, dass in dem einer RF-Antenne bzw. Spule zugeordneten Bereich der gitterförmigen Metallschicht 603 (= leitfähige Schicht) die Rillen des Oberflächenreliefmusters 601 im Mittel mehr längs zur Flussrichtung eines elektrischen Stroms

als quer zur Flussrichtung eines elektrischen Stroms orientiert sind/werden. So wird aus den Figuren 6A und 6B der D1 nicht ersichtlich, wie die Orientierung des Oberflächenreliefmusters 601 zu einer Stromrichtung erfolgt oder dass im Mittel mehr Rillen des
Oberflächenreliefmusters 601 längs als quer zur Flussrichtung eines Stroms auszurichten sind.

Weiterhin geht aus der D1 nicht hervor, dass das <u>Oberflächenreliefmuster 601</u> in dem Bereich, in dem es in der gitterförmigen Metallschicht 603 abgeformt ist, eine Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm sowie eine Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm aufweist.

Schließlich ist der D1 auch keine Angabe darüber zu entnehmen, dass die Rillen des Oberflächenreliefmusters 601 sowohl in der, dem Hologramm zugewandten Oberfläche als auch der, dem Hologramm abgewandten Oberfläche der gitterförmigen Metallschicht ausgebildet wären.

Der neue Anspruch 1 wie auch der neue Anspruch 16 sind somit neu gegenüber D1 und werden von dieser auch nicht nahegelegt.

D2 beschreibt eine Chipkarte mit einer Antennenstruktur. Die als Leiterbahnstruktur ausgebildete Antenne ist dabei aus elektrisch leitfähigem Kunststoff in Vertiefungen eines nicht leitenden Grundkörpers gebildet, wobei die Leiterbahnstruktur in ihrer Längserstreckung einen sich verändernden Querschnitt aufweist (siehe D2, Ansprüche 1 bis 5). Daraus hat die Recherchenbehörde gefolgert, dass in der Leiterbahnstruktur eine "Reliefstruktur" vorliegt, was jedoch objektiv nicht der Fall ist. Auch hier gilt: Wo keine Leiterbahnstruktur vorhanden ist, kann folglich auch keine Reliefstruktur mit Rillen darin abgeformt sein. Ein Gleichsetzen des reinen Querschnittsprofils der Leiterbahnstruktur mit der ersten Reliefstruktur des neuen Anspruchs 1 ist somit nicht zulässig!

Im Hinblick auf die neuen Ansprüche 1 und 16 der Patentanmeldung ist somit festzustellen, dass die D2 nicht offenbart, dass in dem, dem RF-Bauteil zugeordneten Flächenbereich in der Leiterbahnstruktur (=leitfähigen Schicht) zumindest bereichsweise eine erste Reliefstruktur mit Rillen zur Änderung von elektrischen Eigenschaften des RF-Bauteils abgeformt ist/wird.

(

Weiterhin geht aus der D2 somit nicht hervor, dass in dem der RF-Antenne bzw. der Spule zugeordneten Bereich der Leiterbahnstruktur Rillen einer Reliefstruktur in der Leiterbahnstruktur im Mittel mehr längs zur Flussrichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert sind/werden.

Die D2 gibt weiterhin auch keinen Hinweis darauf, dass eine Reliefstruktur in der <u>Leiterbahnstruktur</u> mit einer Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und einer Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm vorhanden sei, oder dass die Rillen sowohl in der, dem Grundkörper zugewandten Oberfläche als auch der, dem Grundkörper abgewandten Oberfläche der Leiterbahnstruktur ausgebildet wären.

Der neue Anspruch 1 wie auch der neue Anspruch 16 sind somit auch neu gegenüber D2 und werden von dieser ebenfalls nicht nahegelegt.

Auch eine Kombination der D1 mit der D2 führt nicht zu den Merkmalen der neuen Ansprüche 1 oder 16 der Patentanmeldung. Die neuen Ansprüche 2 bis 15, 17 und 18 sind von einem dieser Ansprüche 1 oder 16 abhängig.

So wird durch die vorliegende Erfindung ein bestimmtes geometrisches Profil sowie eine geometrische Profilausrichtung in der elektrisch leitfähigen Schicht des RF-Bauteils vorgegeben. Dies führt dazu, dass die physikalischen Abmessungen und/oder die elektrische Performance des RF-Bauteils günstig beeinflusst werden kann. So wird durch die Erfindung bei gleicher Leistung eine geringere geometrische Ausdehnung der elektrisch leitfähigen Schicht (geringere Flächenausdehnung und/oder geringere Schichtdicke) für das RF-Bauteil ermöglicht. Daraus ergeben sich weitere Möglichkeiten bei der Miniaturisierung von RF-Bauteilen sowie Kostenvorteile. Alternativ wird durch die Erfindung eine verbesserte Leistung des RF-Bauteils bei Beibehaltung der Flächenausdehnung oder Schichtdicke der elektrisch leitfähigen Schicht, die zur Bildung des RF-Bauteils verwendet wird, möglich.

Diese Sachverhalte werden durch keine der Entgegenhaltungen D1 oder D2 beschrieben oder angeregt.

#### Zusammenfassung:

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen wird somit gebeten, die Patentfähigkeit der neuen Patentansprüche 1 bis 18 anzuerkennen. Sollten aber hinsichtlich der neuen Anspruchsfassung noch Bedenken im Hinblick auf die Patentfähigkeit bestehen geblieben sein, wird um telefonische Rücksprache gebeten.

Norber Zinsinger

Patentanwalt

Zusammenschluß Nr. 39

### Anhang:

Neue Patentansprüche 1 bis 18 (Reinfassung)

Neue Patentansprüche 1 bis 18 (Fassung mit Änderungen)

#### Neue Patentansprüche

( ,

25

30

- 1. Sicherheitselement (1, 2, 7, 8) zur RF-Identifikation, wobei das 5 Sicherheitselement eine flexible, elektrisch nicht leitende Substratschicht (11, 24) und eine auf der Substratschicht aufgebrachte erste elektrisch leitfähige Schicht (29) aus einem elektrisch leitenden Material aufweist, die in einem ersten Flächenbereich (4, 51, 53, 63, 64, 65) musterförmig zur Bildung eines RF-Bauteils (12, 72, 81) ausgeformt ist, wobei in dem, dem RF-Bauteil zugeordneten 10 Flächenbereich in der ersten elektrisch leitfähigen Schicht (29) zumindest bereichsweise eine erste Reliefstruktur (27, 28, 60) mit Rillen zur Änderung von elektrischen Eigenschaften des RF-Bauteils abgeformt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) im ersten Flächenbereich (2, 51, 15 53, 63, 64, 65) in Form einer RF-Antenne (12) oder einer Spule ausgeformt ist, daß in dem der RF-Antenne (12) bzw. der Spule zugeordneten Bereich der leitfähigen Schicht (29) die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) im Mittel mehr längs zur Flussrichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert sind, und dass die Reliefstruktur (27, 28, 60) eine 20 Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und eine Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm aufweist, wobei die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) sowohl in der, der Substratschicht (11, 24) zugewandten Oberfläche als auch der, der Substratschicht (11, 24) abgewandten Oberfläche der ersten
  - Sicherheitselement nach Anspruch 1,
     d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
     daß die Substratschicht (24) eine Replizierschicht ist und die erste Reliefstruktur
     (27) in die der ersten elektrisch leitfähigen Schicht zugewandte Oberfläche der
     Replizierschicht (27) abgeformt ist.

elektrisch leitenden Schicht (29) ausgebildet sind.

3. Sicherheitselement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) eine auf die Substratschicht (24) aufgebrachte Metallschicht ist.

5

4. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) eine Dicke im Bereich von 50 nm bis 50 µm, bevorzugt von 1 bis 10 µm, hat.

10

15

20

- 5. Sicherheitselement nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Rillen der Reliefstruktur (27) in dem der RF-Antenne bzw. -Spule zugeordneten Bereich der elektrisch leitfähigen Schicht längs der Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert sind.
- 6. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) in dem ersten Flächenbereich (2) in Form ein oder mehrerer Leiterbahnen mit einer Breite von 50 μm bis 10 mm, vorzugsweise 100 μm, ausgeformt ist.
- Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
   daß das Sicherheitselement eine zweite elektrisch leitfähige Schicht (76) aufweist
  und daß im ersten Flächenbereich die erste und die zweite elektrisch leitfähige
  Schicht (73, 76) ein kapazitives Element (70) bilden.
- Sicherheitselement nach Anspruch 7,
   d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
   daß in dem dem kapazitiven Element (70) zugeordneten Flächenbereich in der zweiten leitfähigen Schicht (76) zumindest bereichsweise eine zweite Reliefstruktur (79) abgeformt ist.

Sicherheitselement nach Anspruch 7 oder 8,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die erste Reliefstruktur (78) eine Vielzahl von sich kreuzenden Rillen aufweist.

5

10. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur (27) ein Sägezahn-, Dreieck-, Rechteck- oder Sinusprofil besitzt.

10

11. Optisches Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß die erste Reliefstruktur (60) aus der Überlagerung einer Grobstruktur und einer Feinstruktur gebildet ist.

15

- 12. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die erste Reliefstruktur zusätzlich ein optisches Sicherheitsmerkmal erzeugt.
- 13. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement eine Resonanzschaltung zur RF-Identifikation aufweist.
- 14. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement einen Chip aufweist.
- 15. Sicherheitselement nach einem der vorgehenden Ansprüche,
  da durch gekennzeichnet,
  daß das Sicherheitselement ein Folienelement, insbesondere eine Prägefolie,
  eine Laminierfolie, eine Stickerfolie oder ein Teilelement einer Übertragungslage
  einer derartigen Folie ist.

16. Verfahren zum Erzeugen eines Sicherheitselements zur RF-Identifikation, wobei bei dem Verfahren auf einer flexiblen, elektrisch nicht leitenden Substratschicht (24) in einem ersten Flächenbereich der Substratschicht eine erste leitfähige Schicht (29) aus einem elektrisch leitenden Material musterförmig zur Bildung eines RF-Bauteils (12) ausgeformt aufgebracht wird, wobei in dem, dem RF-Bauteil zugeordneten Flächenbereich (2) in der ersten leitfähigen Schicht (29) zumindest bereichsweise eine erste Reliefstruktur (27) mit Rillen zur Änderung von elektrischen Eigenschaften des RF-Bauteils abgeformt wird, wobei die erste elektrisch leitfähige Schicht (29) im ersten Flächenbereich in Form einer RF-Antenne (12) oder einer Spule ausgeformt wird, wobei in dem der RF-Antenne (12) bzw. der Spule zugeordneten Bereich der leitfähigen Schicht (29) die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) im Mittel mehr längs zur Flussrichtung des elektrischen Stroms als quer zur Flussrichtung des elektrischen Stroms orientiert werden, und wobei die Reliefstruktur (27, 28, 60) mit einer Profiltiefe im Bereich von 50nm bis 10µm und einer Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 2000 Linien pro mm ausgebildet wird, wobei die Rillen der Reliefstruktur (27, 28, 60) sowohl in der, der Substratschicht (11, 24) zugewandten Oberfläche als auch der, der Substratschicht (11, 24) abgewandten Oberfläche der ersten elektrisch leitenden Schicht (29) ausgebildet werden.

20

25

30

(

5

10

15

17. Verfahren nach Anspruch 16,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß die erste leitfähige Schicht (29) vollflächig, insbesondere durch Bedampfung,
auf die Substratschicht aufgebracht wird und dann partiell musterförmig zur
Bildung des RF-Bauteils (12) demetallisiert wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß in der ersten leitfähigen Schicht zwei oder mehr mit Verbindungsbahnen
verbundene kapazitive Teil-Elemente ausgeformt werden und daß
Verbindungsbahnen zu kapazitiven Teil-Elementen später zur Feinabstimmung
der Resonanzfrequenz durchtrennt werden.